



Press Information

电源管理产品

TDK 扩展面向高密度 AI 边缘系统的 micro POL 功率模块产品组合

- 超紧凑型 micro POL 模块 FS3303，尺寸仅为 2.5 × 2.5 毫米，高度仅为 1.2 毫米，可提供 3A 电流，为光模块和 AI 边缘系统实现高密度供电
- 效率高达 95%，工作温度最高可达+90 °C（降额运行可达+125 °C），支持 0.4V 至 3.3V 的低压供电，适用于 ASIC、SoC、DSP 和 AI 芯片组
- 在 TDK 先进的 3D 芯片嵌入式封装中集成控制器、驱动器、MOSFET 和电感器，最大限度地减少外部元件，节省电路板空间

2026 年 5 月 19 日

TDK 株式会社（TSE：6762）宣布推出 FS3303，这是其 micro POL 系列超紧凑型、非隔离式 DC-DC 电源模块的重大扩展中的首款产品，该系列专为 AI 边缘系统和其他空间受限设计中的光模块而设计。FS3303 尺寸仅为 2.5 x 2.5 毫米，高度仅为 1.2 毫米，却能在高达+90 °C 的环境温度下提供 3A 的输出电流（降额后可达+125 °C），并拥有约 95% 的峰值效率。FS3303-0400-AL 目前已全面投产，并已向主要分销商提供样品。

FS3303 以及即将推出的高性能负载点（POL）转换器产品线，可在 0.3 V 至 3.3 V 的工作电压范围内提供 3A 至 80A 的输出电流。它们能够帮助下一代光网络和 AI 加速器平台在不牺牲电路板空间的情况下提升性能。例如，紧凑型光模块的速率已从 10 Gbit/s 提升至 1.6 Tbit/s。新产品组合具有 1.2 毫米至 1.7 毫米的高度规格。

专为低压电源轨设计的 FS3303 支持 2.7V 至 6V 的输入电压和 0.4V 至 3.3V 的输出电压。这使其成为 ASIC、SoC、DSP 和新兴 AI 芯片组的理想之选，尤其适用于需要严格稳压和高瞬态性能的多用途解决方案。

FS3303 采用 TDK 专有的 3D 芯片嵌入式封装技术，集成了控制器、驱动器、MOSFET 和功率电感。这种架构最大限度地减少了外部元件，并提供了完整的 DC-DC 解决方案，显著节省了面积和高度，是下一代光收发器和边缘 AI 模块的理想之选。

关于 TDK 公司

TDK 株式会社（东京证券交易所代码：6762）是一家总部位于日本东京的全球化科技公司，也是电子行业的创新先驱者。秉承 “In Everything, Better” 的理念，TDK 致力于在生活、工业和社会各个领域实现更美好的未来。90 多年来，TDK 始终从内部塑造世界：从开创性的铁氧体磁芯到定义一个时代的盒式磁带，再到以先进的元器件、传感器和电池推动数字时代，一路走向更可持续的未来。秉承 TDK 创业精神——以理想、勇气、信赖为基石的创业思维，TDK 全球各地的热情团队成员致力于追求更好——为自身、客户、合作伙伴及世界创造价值。如今，TDK 的前沿技术已融入现代生活的方方面面，从工业应用、能源系统、电动汽车，到智能手机和游戏设备，无处不在。TDK 全面且创新驱动的产品组合包括前沿无源元件、传感器及传感器系统、电源、锂离子及固态电池、磁头、人工智能与企业软件解决方案等——其中包含众多市场前沿产品。这些产品以 TDK、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI 及 ATL 等品牌进行市场销售。将人工智能生态系统定位为关键战略领域，TDK 依托其在全球汽车、信息与通信技术及工业设备领域的全球网络，拓展业务至多个领域。在 2026 财年，TDK 的销售总额为 166 亿美元，全球员工约为 107,000 人。

请到本公司的新闻网站下载本新闻稿和相关图片 https://www.tdk.cn/zh/news_center/press/20260519_01.html
如欲获取更多有关本产品资料请点击 https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/power/switching-power/micro-pol/data_sheet/fs3303_datasheet.pdf

地区媒体联系方式

地域	负责人	所属	电话号码	邮件地址
Greater China	Ms.Clover XU	TDK China Co., Ltd.	+86 21 61962307	TDK.PR-CN@tdk.com